

●冷熱衝撃試験

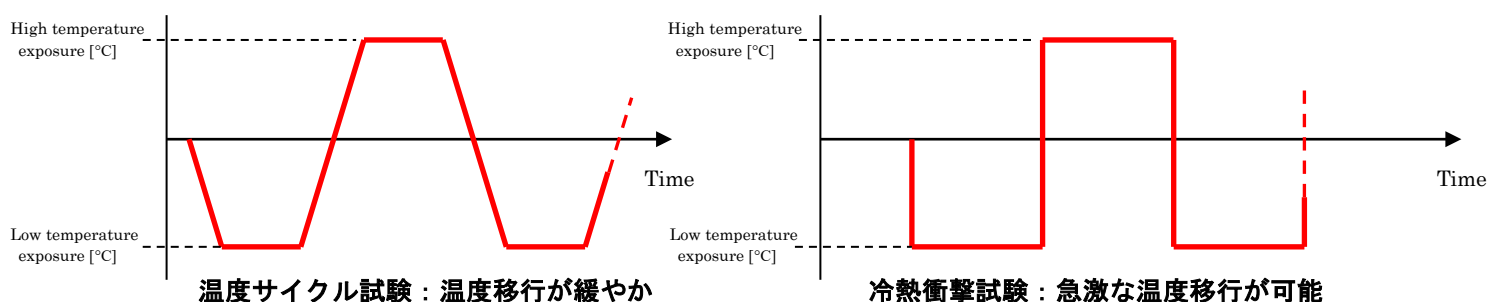
TN317

Thermal Shock Test

[概要]

異種材料で構成接合された電子部品、および、それらが組込まれた製品は、使用環境や動作過程により短時間での急激な温度変化にさらされると、膨張や収縮により、異種材料が接合された部分で熱膨張率や熱容量の違いに起因する熱応力による剥離等の不具合・故障が発生する可能性があります。

冷熱衝撃装置では、下記イメージ図のように一般的な恒温槽を使用した温度サイクル試験と異なり、温度復帰性能が良いため、より厳しい環境を模した評価が可能です。



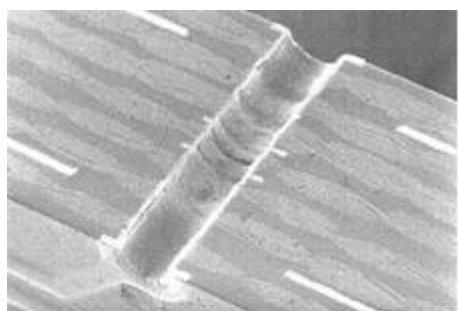
Keywords: 受託分析、ヒートショック、信頼性試験、環境試験、加速試験

[用途例]

対象品	電子デバイス	基板	実装基板などのセット部品
評価例	ボンディングワイヤの断線、剥がれ パッケージの反り チップのクラック、剥がれ	反り スルーホール亀裂、断線、剥がれ ビアホール亀裂、断線、剥がれ	はんだ接合部の劣化、剥がれ (RoHS 対応品等)

[装置仕様]

- 試験方式 : 試料上下移動による2ゾーン方式
- 高温さらし温度 : +60 °C ~ +200 °C
- 低温さらし温度 : -65 °C ~ 0 °C
- 試験規格 : JIS C 60068-2-14、IEC 60068-2-14、JASO D014-4
- 最大積載試料サイズ : W320 × D230 × H145 mm
- ケーブル孔 : 1個 (通電対応可能)



Example of breakage of through-hole plating



Example of peeling of solder on terminals